苏州赛伍应用技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-004

		列 分 : 2023-004
	□特定对象调研	□分析师会议
投资者关系活动类别	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	√路演活动
	□现场参观	√一对一沟通
	□线上会议	
参与单位名称及人员姓名	国新国正基金、东方财富证券、东财基金、国信证券、盘京投资、方正证券、国泰海通证券	
时间	2025年9月	
地点	线上、上海、苏州	
上市公司接待人员姓名	董秘 陈小英、投关总监 万宣宣	
	问题1.2025年上半年经营概括?	
	胶膜原材料价格下滑幅 经营有所影响。光伏板 持出货增长,胶膜业务 续增长,整体收入同比	是背板业务下游需求低迷出货量下降以及上游度小于胶膜产品价格下降幅度的影响,公司块胶膜市占率进一步提升,海外市场业务保进一步提升市占率。非光伏板块业务保持持增长28.04%,收入占比进一步提升,未来将先地位的基础上,持续依靠强大的研发能力
加炉サルズパール・エム	问题2. 胶膜业务的海外市场拓展计划是什么?	
容介绍	A:公司积极布局胶膜流 满产,目前在手订单充 本、土耳其、越南、中 在TOPCon组件海外市均	每外市场,越南生产基地5GW胶膜产线已经裕,未来将进一步拓展包括印度、欧盟、日国台湾等地区的市场,同时重点推广光转膜场的持续交付。为满足海外市场日益增长的过轻资产模式扩产,完成胶膜扩产计划,进
	问题3: 锂电和新能源汽车材料业务近况?	
		材料业务是公司重点发展的业务板块,今年方米,同比增长83.19%;实现营业收入2.89

亿元,同比增长48.90%。目前锂电和新能源汽车材料需求旺盛,产 线均处于满产状态。公司重视与下游客户协同创新,通过技术创新 驱动材料升级,为下游客户创造价值,公司看好下游FCC/FFC信息 采集组件的应用前景,目前材料己实现量产并实现快速增长。

问题4. 半导体业务的研发、竞争及未来规划如何?

A: 公司在半导体领域已持续深耕四年,目前业务涉及半导体封装、LED、MLCC等泛半导体行业一站式综合材料解决方案,半导体行业对产品技术以及批次稳定性要求较高,目前以日韩企业为主(如林得科、日东电工、三井化学等)。公司目前拥有包括CMP固定胶带、功率晶圆研磨用途 UV 减粘胶带、先进封装FC 晶圆BG研磨胶带、晶圆级切割工序各类切割胶带、引线框架封装用途耐高温QFN 前/后贴膜、MLCC切割用途冷剥离胶带、MLCC切割用热减粘胶带等产品。其中CMP固定胶带、MLCC用热减粘胶带等产品实现下游客户稳定交付,目前进入放量阶段,未来公司将不断完善半导体产品矩阵,以加强业务板块的市场竞争力。

问题5. 消费电子业务的发展情况如何?

A: 公司在消费电领域耕耘多年,抓住消费电子市场回暖以及供给端国产替代的时间窗口,显示、声学等产品在下游客户处放量。显示材料:公司 OLED用上/下保护膜在前期经过小批量客户导入后,目前处于快速放量期; MicroLED基板切割保护膜、MicroLED用高洁净保护膜已经实现小批量量产; MicroLED用承接胶、MicroLED用黑色热固胶处于下游客户导入阶段,未来有望实现量产。声学材料:公司声学用橡胶膜、声学用亚克力胶膜等主流产品与下游客户合作稳定,出货量和收入均实现快速增长。

问题6.公司如何避免用光伏经验开发半导体材料,实现业务差异管理?

A:和光伏产线相比,半导体制程材料及光学膜类产品对研发、 测试评价、质量管控、运营管理等要求更高。生产环境需要千级/百级,设备的涂布精密性要求也较高。去年公司专门成立精密涂布制造部,主要用于生产半导体制程材料以及光学膜类产品,生产车间、设备独立运营,实现专线专用。同时研发团队及平台也独立运作,满足半导体和光学膜业务的发展需求。

问题7. 公司AI实验室介绍?

A:公司联合苏州大学引入"AI+新材料"创新思路,建立AI实验室,该AI实验室能够构建材料开发模型与专用数据库,加速新材料研发;为关键研发项目提供精准计算与模拟服务;同时搭建安全高效的私有云平台,为研发工作提供强大算力支撑。公司目标借助AI平台,能够提升研发效率、提高创新精确性,助力公司平台化、多元化的可持续发展。

问题8. 公司在钙钛矿方面的进展?

A: 公司作为钙钛矿组件封装材料的头部生产厂商,凭借自身多年研发投入和提前布局,钙钛矿组件用封装胶膜持续交付并处于快速增长,今年上半年公司TPO胶膜出货量同比增长211.0%。此外,公司始终坚持与下游客户协同创新,近期与国内头部光伏企业达成钙钛矿光伏材料战略合作,为合作企业钙钛矿组件提供一站式高分子材料解决方案,包括TPO胶膜的批量交付意向以及Raybo光转胶

	膜,低温层压胶膜等封装材料及阻水材料的验证。
附件清单(如有)	无
日期	2025年9月30日